вание дистанционной зависимости разрешающей способности сканирующего зонда Кельвина // Приборы и методы измерений. – 2012. –№ 1(4). – С. 30-36.

3. Danyluk S. Kelvin probe's stray capacitance and

УДК 537.58:621.891

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСИ ЖЕЛЕЗА В КРЕМНИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ЗОНДОВОЙ ЭЛЕКТРОМЕТРИИ

Воробей Р.И.¹, Жарин А.Л.¹, Микитевич В.А.¹, Тявловский А.К.¹, Тявловский К.Л.¹, Пилипенко В.А.², Петлицкий А.Н.²

No

1

¹Белорусский национальный технический университет Минск, Республика Беларусь ²ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» Минск, Республика Беларусь

характеристики приборных На полупроводниковых структур определяющее влияние оказывают дефекты кристаллической структуры исходной заготовки (кремниевой пластины). Присутствие в кристаллической решетке кремния атомов таких металлов как железо, медь, золото, никель и некоторых других приводит к возникновению центров рекомбинации, вероятность захвата и ре-комбинации неравновесных носителей заряда (ННЗ) на которых достаточно высока, что приводит к уменьшению времени жизни и длины диф-фузии HH3 и, соответственно, снижению элек-трических характеристик полупроводникового устройства. Наиболее значимой является примесь железа, источником которой являются элементы технологического оборудования, изготовленные из стали. Используемые в настоящее время методы контроля примесей металлов в кремнии носят разрушающий характер, связаны с повреждением поверхности полупроводниковой пластины и вследствие этого требуют использования пластин-спутников, что снижает производительность линии (за счет изъятия части заготовок из технологического процесса на разных его стадиях), уве-личивает себестоимость конечной продукции и не обеспечивает необходимой достоверности контроля.

Разработанная методика визуализации пространственного распределения примеси железа в кремнии предусматривает исследование поверхности сканирующим электрометрическим зондом (зондом Кельвина), обеспечивающим регистрацию контактной разности потенциалов (КРП) или, при использовании дополнительного воздействия оптическим излучением, поверхностной фотоЭДС без непосредственного механического контакта зонда с исследуемой поверхностью [1]. За счет этого обеспечивается отсутствие каких-либо разрушающих воздействий на поверхность образца. В основу определения концентрации примеси железа в кремнии положена двукратная регистрация поверхностной фото-ЭДС до и после воздействия на полупроводниковую пластину умеренным нагревом (до 200 °C) в течение 1...10 минут. Согласно общепринятой теоретической модели, атомы железа, попадающие на поверхность кремния р-типа в виде загрязнений, хими-чески связываются с легирующей примесью бора, формируя пары Fe-B. Из-за нестойкости данного соединения кратковременный нагрев загрязненной полупроводниковой пластины до температуры 180...200 °С приводит к распаду пар Fe-B на легирующий бор и интерстициальное железо Fe_i, атомы которого располагаются между узлами кристаллической решетки кремния [2]. В отсутствие создаваемых парами Fe-B центров рекомбинации время жизни ННЗ в приповерхностных слоях кремния возрастает, что может быть зарегистрировано по изменению величины поверхностной фотоЭДС [3]. Интенсивный процесс повторного формирования пар Fe-B начинается спустя 2 ч после охлаждения образца до комнатной температуры [2], вследствие чего дальнейшие измерения должны выполняться в пределах этого интервала времени.

noise simulation / S. Danyluk, A.V. Dubanevich,

O.K. Gusev, A.I. Svistun, A.K. Tyavlovsky, K.L. Tyavlovsky, R.I. Vorobey, A.L. Zharin // De-

vices and Methods of Measurements. - 2014. -

Р

94-98.

Данная методика реализована в конструкции и программном обеспечении разработанной в НИЛ полупроводниковой техники БНТУ измерительной установки для неразрушающей бесконтактной характеризации полупроводниковых структур с субмикронными слоями по параметрам пространственного распределения времени жизни и примеси железа в кремнии р-типа (рисунки 1 и 2). Рабочее пространство установки разделено на две изолированные зоны: зону измерений и зону нагрева. Образец (полупроводниковая пластина диаметром до 200 мм) закрепляется на подвижном держателе с помощью вакуумного прижима (присоски). Система трехкоординатного переме-щения на основе шаговых двигателей обеспечивает как сканирование поверхности образца, так и его перемещение в зону нагрева и обратно. Источником нагрева служит инфракрасный керамический нагреватель с располагаемой мощностью нагрева до 2 кВт. В нормальном режиме работы установки установленная мощность нагрева не превышает 1 кВт. Управление процессом нагрева осуществляется с помощью ПИД-регулятора с термопарой в цепи обратной связи, чем обеспечивается быстрый и плавный нагрев с точным поддержанием температуры без существенного перерегулирования.



1 – основание; 2 – зона измерений;
3 – зона воздействия нагревом; 4 – держатель образцов; 5 – привод перемещения по координате Х;
6 – привод перемещения по координате Y;
7 – источник коронного разряда и электрометрический зонд; 8 – источник оптического излучения;
9 – инфракрасный нагреватель. 10 – электронные блоки установки
а) вид сбоку; б) вид сверху





Рисунок 2 – Внешний вид измерительной установки

Пример визуализации пространственного распределения примеси железа в кремнии показан на рисунке 3. Рисунок 3(а) демонстрирует зарегистрированное распределение длины диффузии ННЗ до нагрева пластины, рисунок 3(б) – после. На рисунке 3(в) показан результат автоматиче-ского вычисления концентрации примеси железа в кремнии на основе данных этих двух сканирований и заложенной в программное обеспечение установки математической модели.



 а – распределение длины диффузии ННЗ до нагрева; б – то же, после нагрева;
в – распределение примеси железа в кремнии

Рисунок 3 – Пример визуализации пространственного распределения примеси железа в кремнии на основе методов зондовой электрометрии

 Воробей Р.И. Контроль дефектов структуры кремний-диэлектрик на основе анализа пространственного распределения потенциала по поверхности полупроводниковых пластин / Воробей Р.И., Жарин А.Л., Гусев О.К., Петлицкий А.Н., Пилипенко В.А., Турцевич А.С., Тявловский А.К., Тявловский К.Л. // Приборы и методы измерений. – 2013. –№ 2(7). – С. 67-72.

- Choi B.-D. Latent Iron in Silicon / B.-D. Choi, D.K. Schroder, S. Koveshnikov, S. Mahajan // Jpn. J. Appl. Phys. – 2001. – V. 40. – P. 915-917.
- Воробей. Р.И. Использование эффекта поверхностной фотоЭДС для определения примеси железа в кремнии / Р.И. Воробей, А.Л. Жарин, А.Н. Петлицкий, В.А. Пилипенко, А.И. Свистун, А.К. Тявловский, К.Л. Тявловский // Приборостроение-2013: материалы 6-й Международной научно-технической конфе-ренции (20-22 ноября 2013 г.). – Минск: БНТУ. – 2013. – С. 162-163.